



株式会社 オプトラ

～ 1Q業績はスマホなど光学事業領域の成長が貢献 ～

2024年12月期1Q 決算説明資料

2024年5月13日

光学薄膜装置



半導体光学融合装置



電子デバイス装置



□ 将来の見通しについて

本資料には、「将来の見通しに関する記述」が含まれています。この記述には、当社の事業と市場における予想される成長と傾向、業界の見通しと需要要因、当社の投資と成長戦略、新製品と新技術の開発、現在および今後の事業見通しに関するものが含まれます。今後、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、予想・計画見通しと大きく異なる可能性があります。更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

□ 為替リスクについて

当社の主力製品である製造装置の輸出売上高は、米ドル建ての依存度が高いことから、米ドルの為替変動の影響を受けます。製造原価は中華圏生産の依存度が高いことから、中国元の変動影響を受けます。業績見通しの為替前提は、過去の実績を踏まえて想定し、為替変動影響の軽減を目指しています。当社の輸出先は中華圏の依存度が高いものの、最終需要先は世界的に広がっています。

□ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

当社は資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応方針として、中期経営計画の経営目標において「営業利益率」、「ROE」を定めています。株主価値の向上にむけて、安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を行う想定にしております。ただ、持続的な成長を見据え、積極的な研究開発、設備投資、M&Aなど含む戦略的事業提携を計画しています。問い合わせ先は、E-mail:ir-info@optorun.co.jp

□ 24年12月期1Q(1-3月)の連結受注高及び業績実績

受注高はスマートフォン(以下スマホ)関連投資の回復により、前年比16%増の111億円と好転した。特にスマホ・カメラモジュール向けALD装置(Atomic Layer Deposition:原子層堆積)の引き合いが増加した。売上高もALD装置の貢献度上昇により、同25%増の113億円、営業利益は同52%増の40億円と拡大した。経常利益は為替関連差損の減少により大幅増益となった。為替実績は151.41円/ドル、20.83円/人民元。

□ 24年12月期の連結受注高及び業績予想と事業環境

受注高はAIスマホ関連投資の拡大で回復が期待されます。売上高は光学領域の奏効により、前年比1%増の370億円を予想。営業利益は円高や価格競争激化を踏まえて、同23%減の76億円に減少するも、経常利益は同25%増の76億円と増益を予想。為替前提は130円/ドル、20.5円/人民元。営業利益感応度は1円/ドルの円高で△1.5億円、0.1円/人民元の円高で+1億円の影響が試算されます。

□ 中期経営計画と次期事業戦略

当社は経営目標として、営業利益率20%超、ROE(自己資本利益率)10%超を想定しています。株主価値の向上に向けて、連結配当性向30%以上を前提とする安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を想定しております。24/12期年間1株当たり配当金は52円(中間配当金26円)を計画。次期事業戦略において、事業領域展開に示すとおり、光学に加えて半導体光学融合や電子デバイスを事業成長の柱にする方針です。

光学

半導体光学融合

電子デバイス

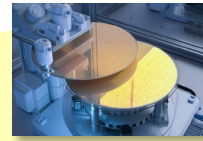


■ AI スマートフォン

- ・ CMOSイメージセンサ
- ・ ペリスコープレンズ

■ EV/コネクテッドカー

- ・ ADAS(先進運転支援システム)
- ・ 統合コックピット/モビリティ



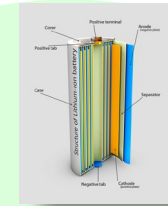
■ 光電融合デバイス

- ・ データコムトランシーバ
- ・ ボード接続用デバイス

生成AI革命

■ 空間コンピュータ

- ・ Micro LED/LiDARセンサ
- ・ OLEDディスプレイ



■ グリーンエネルギー

- ・ パワー半導体
- ・ 全固体電池

■ 通信デバイス

- ・ ミリ波デバイス
BAW/SAW/RF



受注高及び業績



図表1: 受注高、業績及び1株当たり指標・財務指標(単位:百万円、円、%)

項目	決算期	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12		前年比%	
								1Q	通期予	1Q	通期予
受注高		39,821	36,062	28,606	35,435	43,124	24,080	11,136	-	16.4	-
受注残高		39,228	32,468	23,583	28,126	36,947	24,219	24,058	-	-35.8	-
売上高		44,763	42,822	37,491	30,892	34,304	36,807	11,298	37,000	24.7	0.5
営業利益		10,690	10,879	8,628	7,025	7,449	9,752	3,965	7,500	51.7	-23.1
経常利益		10,993	11,031	8,610	7,901	8,763	6,051	4,325	7,600	138.3	25.6
税前利益		10,748	11,488	8,678	8,773	9,405	5,998	4,321	-	138.1	-
法人税等		3,001	2,386	1,874	2,440	2,512	1,325	1,030	-	148.8	-
当期純利益		7,746	9,102	6,797	6,330	6,890	4,632	3,284	5,400	134.1	16.6
1株当たり当期純利益		187.6	216.7	159.1	146.8	159.0	106.1	75.0	123.2	132.5	16.1
1株当たり配当金		55.0	60.0	50.0	50.0	50.0	50.0	-	52.0	-	4.0
1株当たり純資産		676.2	821.1	919.0	1,066.0	1,199.1	1,285.3	1,343.9	-	12.5	-
売上高総利益率		39.0	41.3	39.2	43.3	43.6	50.1	52.4	-	1.9	-
売上高営業利益率		23.9	25.4	23.0	22.7	21.7	26.5	35.1	20.3	6.3	-6.2
法人税率		27.9	20.8	21.6	27.8	26.7	22.1	23.8	-	1.0	-
棚卸資産回転日数		327.1	220.4	178.4	268.1	385.2	357.7	275.0	-	-40.5	-
自己資本利益率		30.6	29.0	18.3	14.8	14.0	8.5	-	-	-	-

注: 会計は日本基準、予は当社予想、数値は百万円以下を四捨五入で算出、利益率の前年比%欄は前年比増減

貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書



図表2: 主な貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の概要(単位:百万円)

項目	決算期末	18/12	19/12	20/12	21/12	22/12	23/12	24/12 1Q
現金・預金		15,741	26,970	22,723	32,274	34,923	33,054	33,329
受取手形・売掛金(貸倒引当金含む)		6,417	3,902	9,426	5,627	7,423	4,882	3,206
棚卸資産		24,487	15,173	11,147	12,855	20,430	17,989	16,213
流動資産		48,142	47,194	44,572	53,145	65,401	57,632	55,184
固定資産		7,502	9,315	9,755	11,529	17,515	20,859	21,775
総資産		55,644	56,509	54,327	64,675	82,916	78,491	76,959
支払手形・買掛金		1,653	2,735	1,703	3,246	4,785	1,284	2,326
短期有利子負債(リース債務含む)		757	510	489	472	414	403	402.8
契約負債(従来、前受金と表記)		20,109	13,989	8,922	9,831	19,060	14,743	9,441
流動負債		25,923	19,826	13,655	17,057	28,400	19,097	14,812
固定負債		1,659	1,864	1,157	1,535	2,357	2,478	2,637
純資産		28,063	34,819	39,515	46,084	52,159	56,916	59,510
営業キャッシュ・フロー		9,572	16,233	-535	10,686	8,561	3,180	-
投資キャッシュ・フロー		-2,964	-2,432	-1,048	376	-4,396	-3,599	-
フリーキャッシュ・フロー		6,608	13,801	-1,583	11,061	4,165	-419	-
財務キャッシュ・フロー		-10,054	-2,359	-2,467	-2,735	-2,172	-2,207	-

注: 数値は百万円以下を四捨五入で算出、受取手形・売掛金は貸倒引当金を考慮、短期有利子負債は短期借入金とリース債務の合計

□ 24年12月期の1Q連結受注高及び業績実績

受注高はスマートフォン(以下スマホ)関連投資の回復により、前年比16%増の111億円と好転した。特にスマホ・カメラモジュール向けALD装置(Atomic Layer Deposition:原子層堆積)の引き合いが増加した。売上高もALD装置の貢献度上昇により、同25%増の113億円、営業利益は同52%増の40億円と拡大した。経常利益は為替関連差損の減少により大幅増益となった。為替実績は151.41円/ドル、20.83円/人民元。

スマホ市場は需要成熟化により代替サイクルが長期化していましたが、AIスマホの登場・販売好調により、弊社は新型装置の受注を獲得できました。AI機能搭載の最先端半導体チップセット、1インチイメージセンサーやダブルペリスコープ、トリプルフォルダブルディスプレイなどの新技術の採用で、スマホは高付加価値商品の需要が喚起される可能性もあります。ただ、地政学的なリスクや景気減速の懸念もあり、慎重な判断をしています。

□ 24年12月期の連結受注高及び業績予想と事業環境

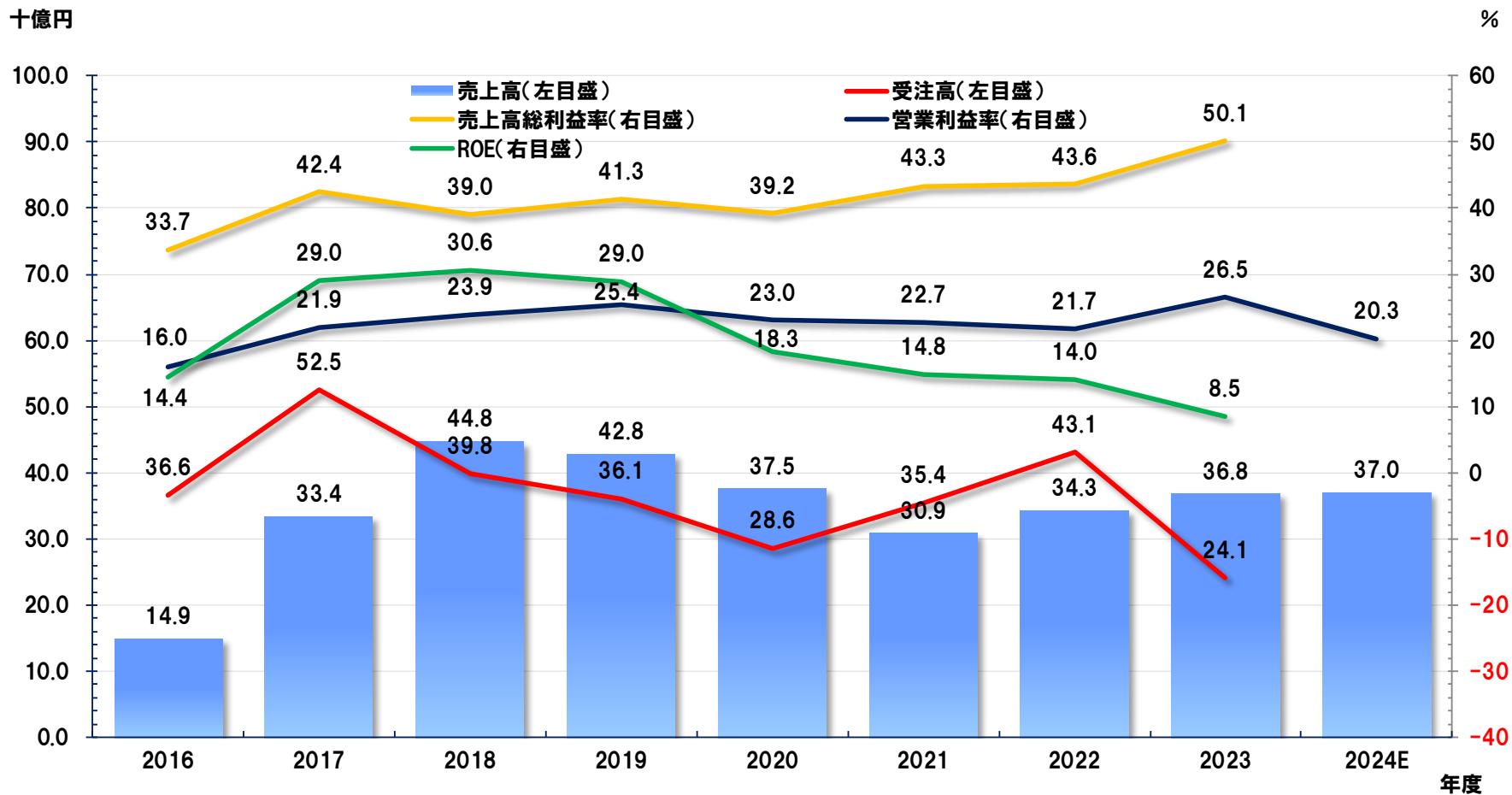
受注高はAIスマホ関連投資の拡大により回復が期待されます。売上高は光学事業領域の拡大による小幅増収を予想。営業利益は円高や価格競争激化を踏まえて減益を予想しますが、経常利益は増益を想定しています。為替前提は130円/ドル、20.5円/人民元と現行レートより慎重に判断しています。営業利益感応度は1円/ドルの円高で△1.5億円、0.1円/人民元の円高で+1億円の影響です。

生成AI革命により、光学、半導体光学融合、電子デバイスの全事業領域を通じて、成膜需要拡大が期待されます。スマホ上位機種での生成AI機能搭載、カメラの複眼化・大判化による高機能化は、新規装置の需要を喚起すると予想。半導体光学融合事業は、重要注力分野と位置付け、積極的な研究開発およびIP投資やM&Aなどを行う計画です。EV/車載分野は、自動運転技術向上に伴う新たな装置需要を想定しています。

受注高、売上高及び収益性・収益力指標

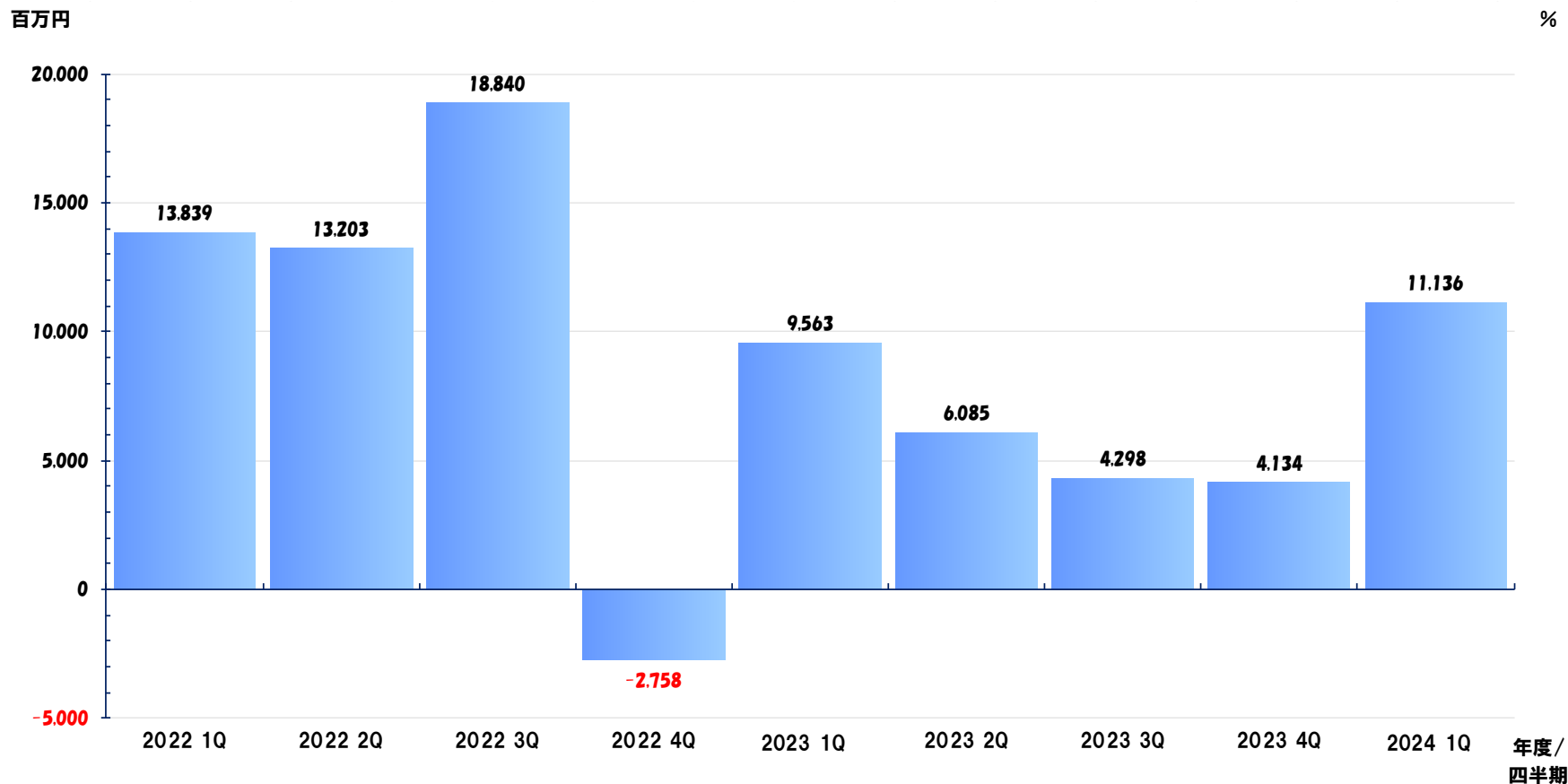


図表3: 受注高、売上高及び収益性・収益力指標



注: 24/12期の為替前提は130円/ドル、20.5円/人民元。営業利益感応度は1円/ドルで円高で△1.5億円、0.1円/人民元の円高で+1億円の影響

図表4: 四半期受注高

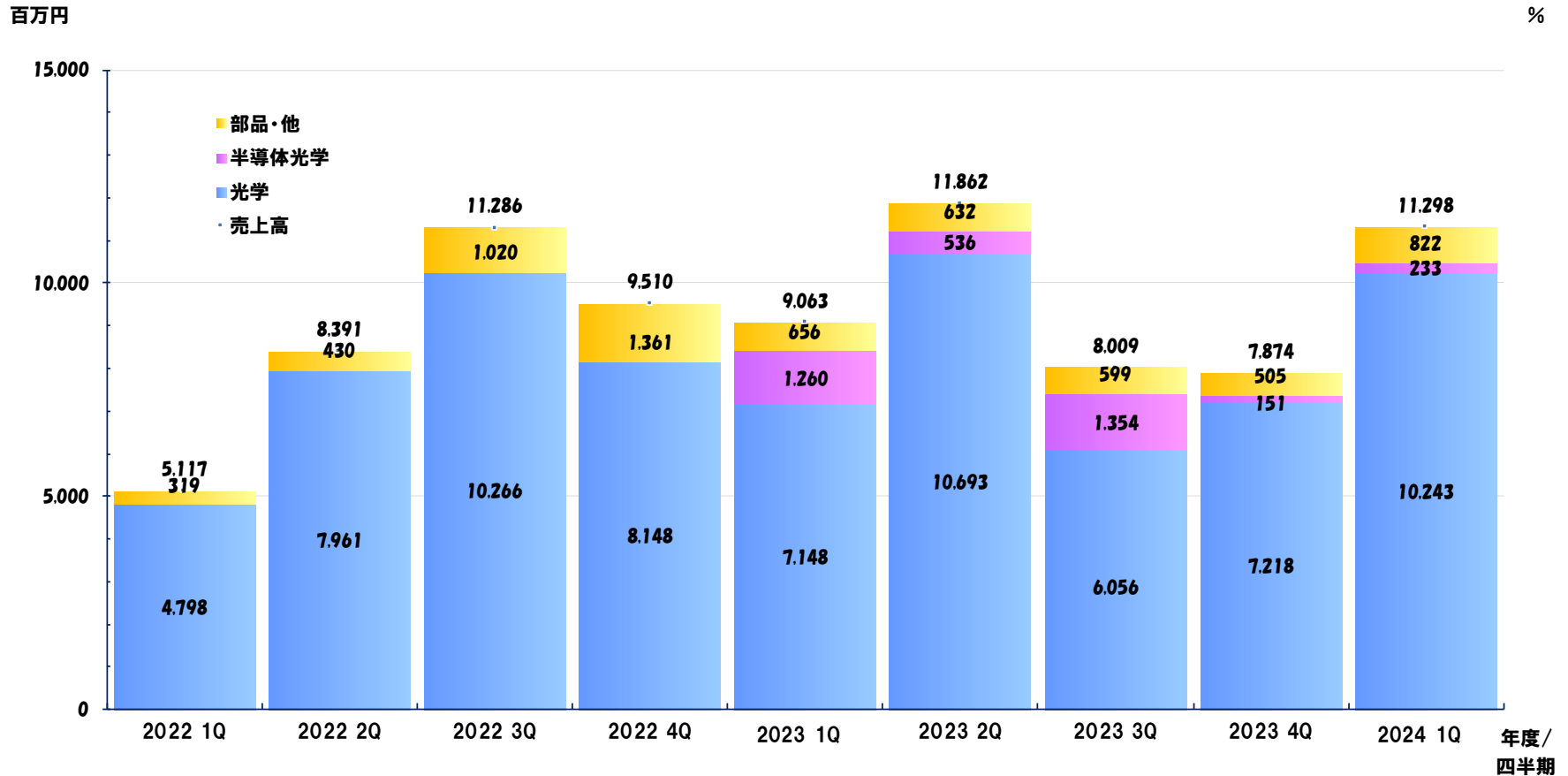


注: 受注高の事業領域別数値は24/12期から非開示

事業領域別の四半期売上高



図表5: 事業領域別の四半期売上高



注: 光学事業領域にはAIスマホ、EV/コネクテッドカー、光学部品を含む、半導体光学融合・電子デバイス事業領域は光電子、空間コンピュータ、光電融合デバイス、グリーンエネルギー、通信デバイス、MEMSデバイスを含む

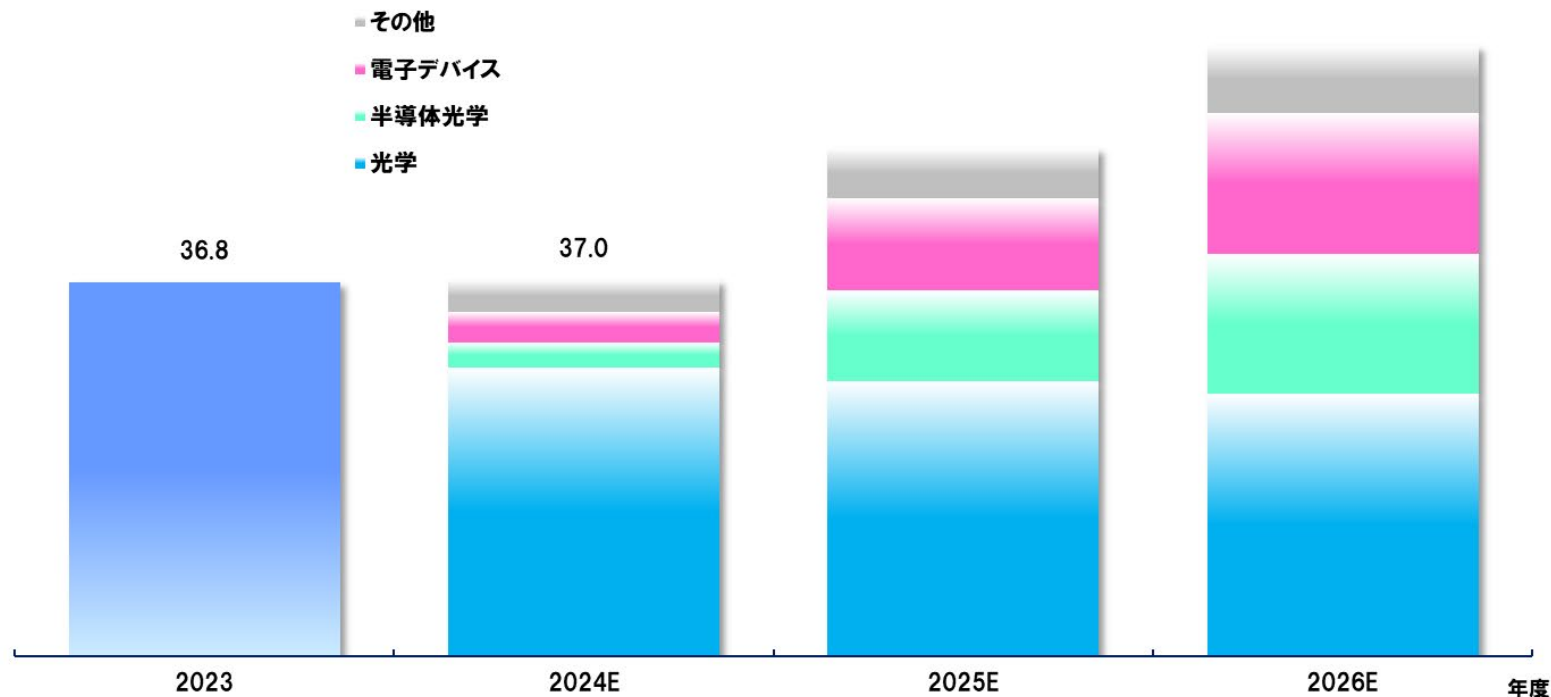


中期經營方針

□ 中期経営計画と次期事業戦略

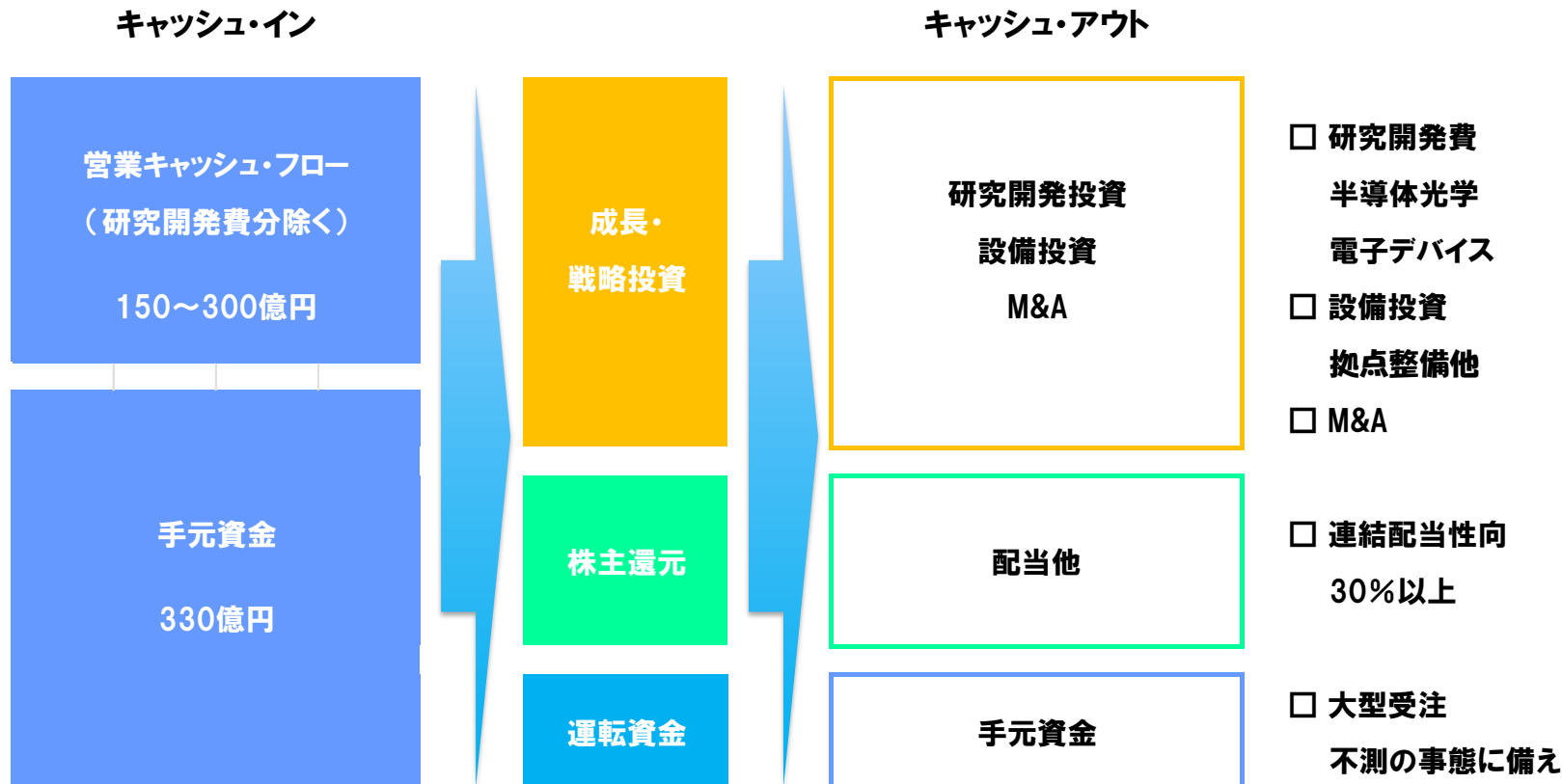
経営目標として、営業利益率20%超、ROE(自己資本利益率)10%超を想定。株主価値の向上に向けて、連結配当性向30%以上を前提とする安定配当と機動的・戦略的な自己株式取得を検討しています。24/12期の年間1株当たり配当金は52円(中間配当金26円)を計画。次期事業戦略において、事業領域展開に示すとおり、光学に加えて半導体光学融合や電子デバイスを事業成長の柱にする方針です。

図表6:事業領域別中期経営目標(単位:十億円)



キャッシュ・アロケーション(3カ年)

図表7:キャッシュ・アロケーション



設備投資・研究開発費計画

図表8:設備投資・減価償却費・研究開発費

日本本社 鶴ヶ島



- ・ 半導体光学・電子デバイス等
- ・ 先端分野研究開発拠点 準備中

半導体技術 上海

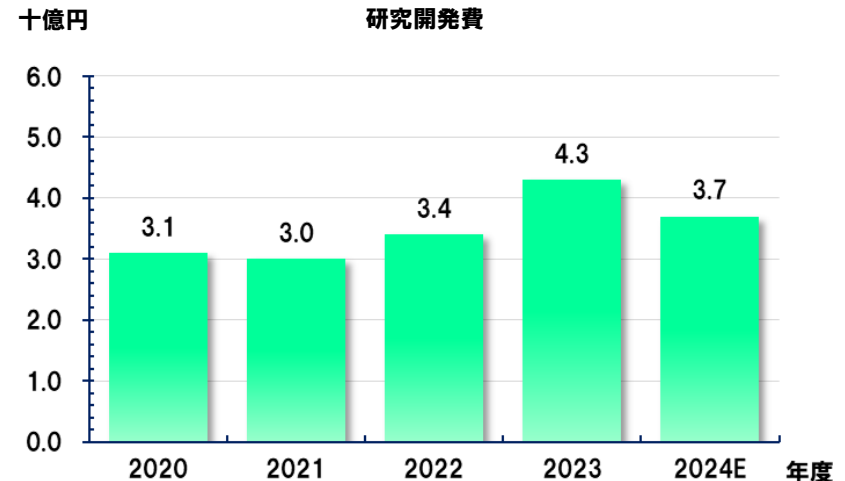
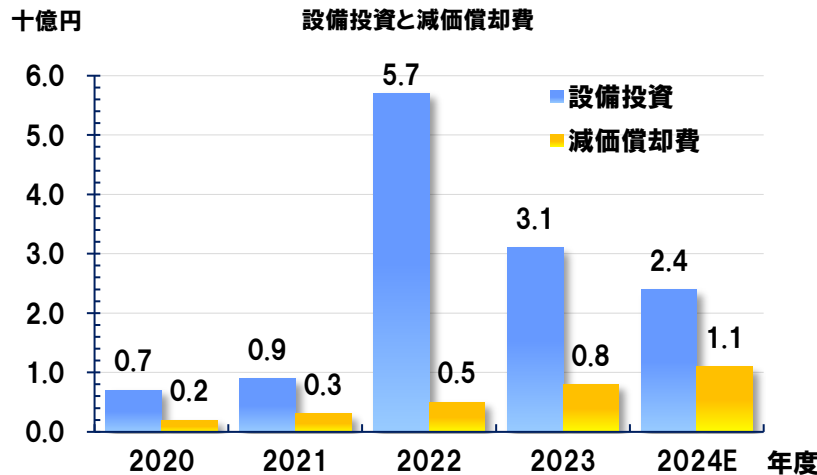


- ・ ALD装置等の新技术装置の生産・研究開発拠点、2024年1月稼働開始

ベトナム ハノイ近郊



- ・ 装置設計・東南アジアの顧客への装置据付・保守修理、部品加工販売
2023年12月稼働開始

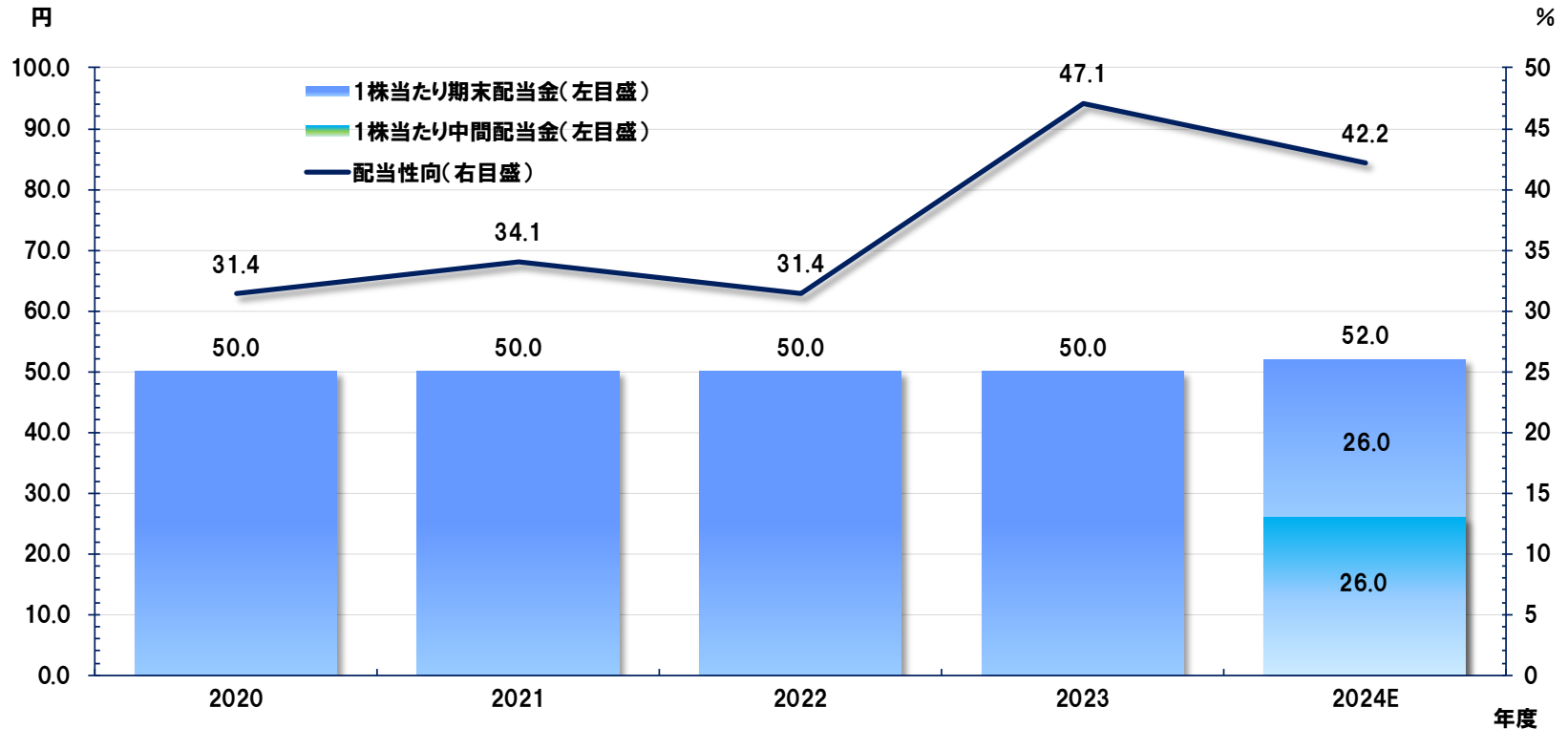


株主還元策・配当予想

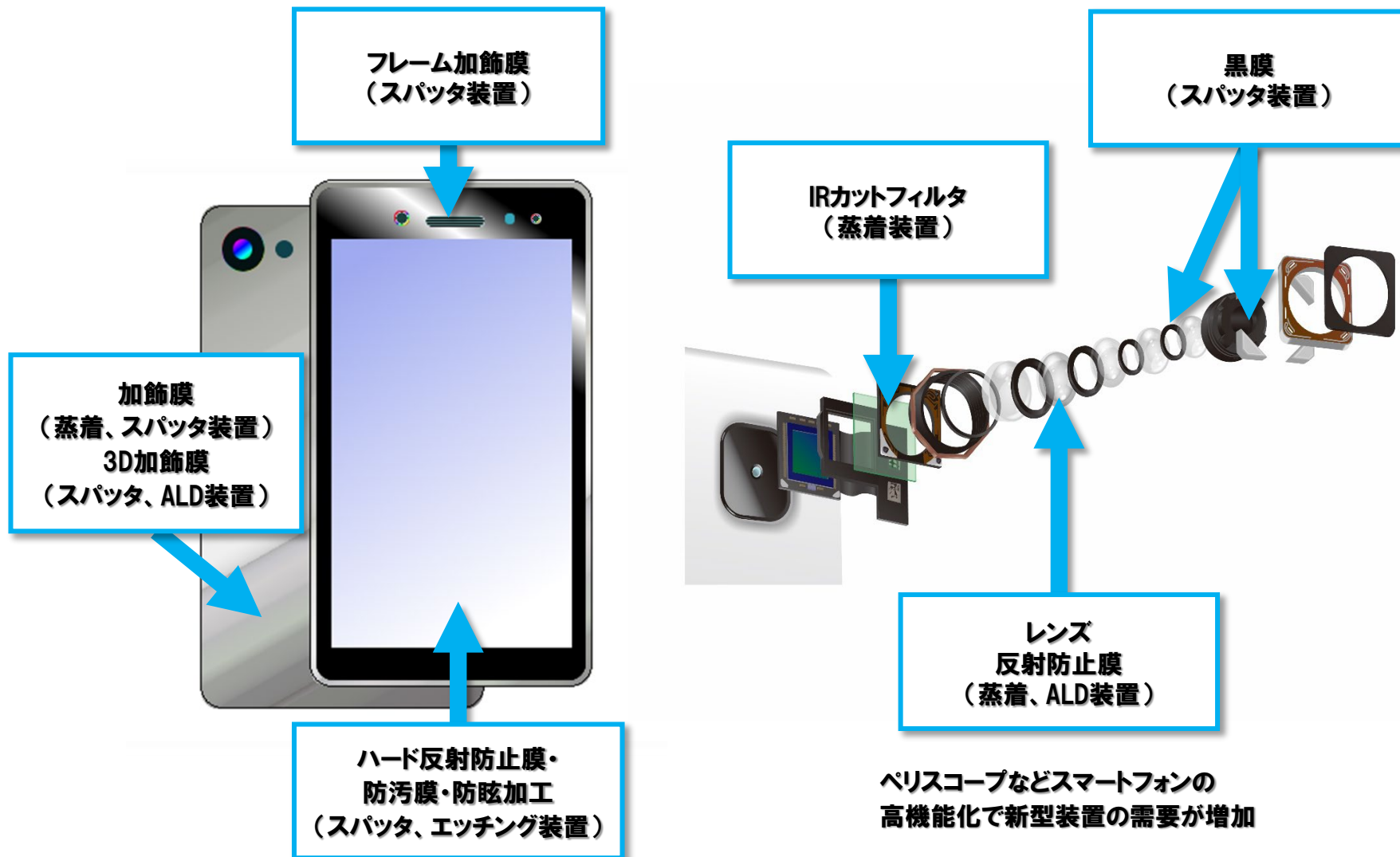
□ 株主還元策・配当予想

研究開発投資、生産体制強化、新事業開拓等の必要な内部留保資金を確保しつつ、連結配当性向30%以上を前提として株主還元を実施します。株主価値向上を目的として、24年12月期より中間、期末の年2回配当を実施する想定であり、24年12月期通期配当は52円を予定しています。収益状況が大きく変動する際は、配当金を見直す可能性があります。

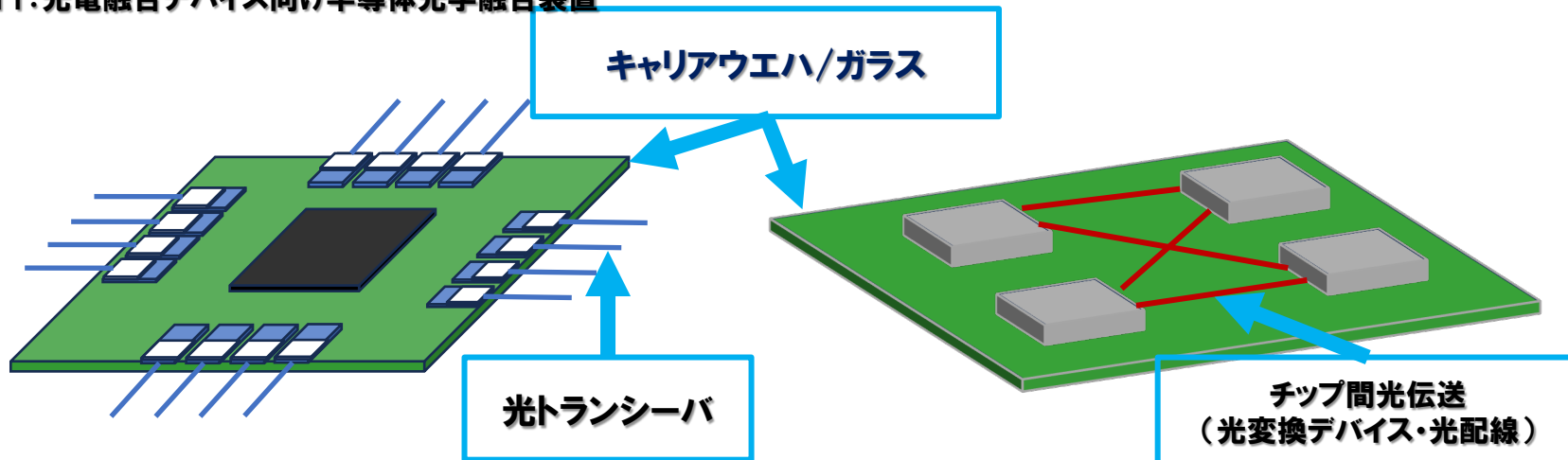
図表9: 1株当たり配当金と年間配当性向



図表10: AIスマートフォン向け光学薄膜装置



図表11:光電融合デバイス向け半導体光学融合装置

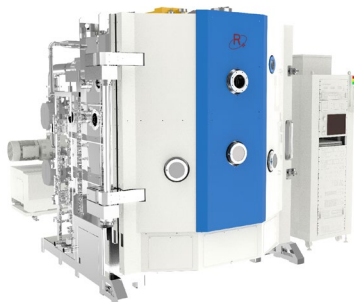


光電融合技術により、チップ間光伝送デバイスの実現に貢献へ

第2世代 光通信

第3世代 光通信

第3.5世代 光通信



蒸着装置



スパッタ装置

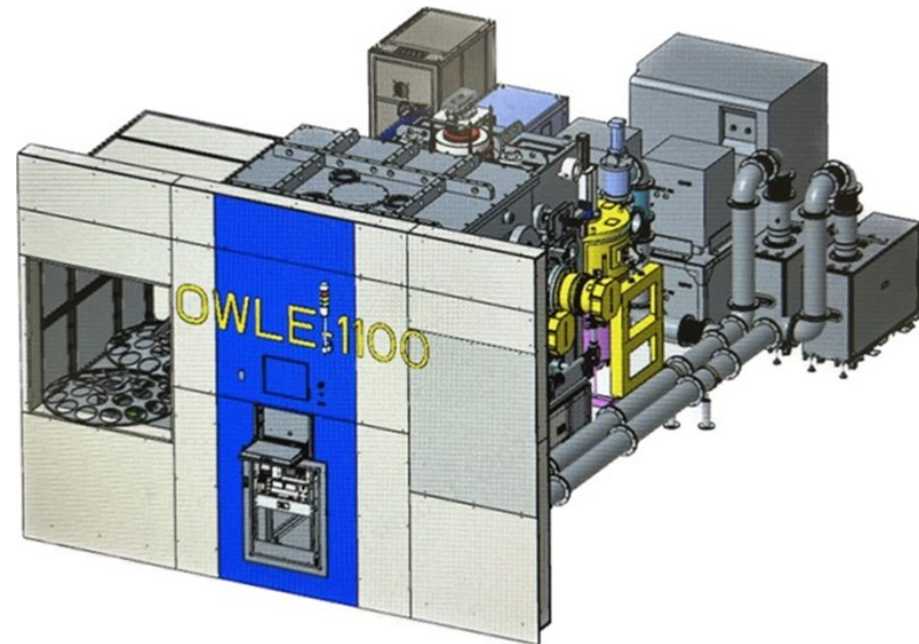
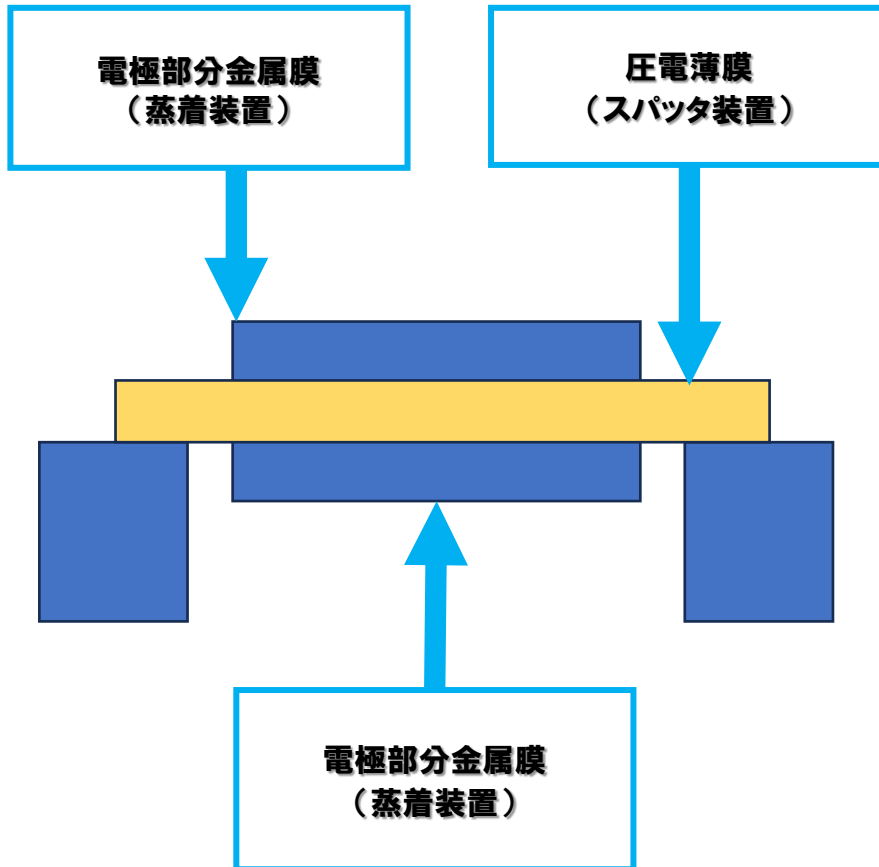


ALD装置

図表12:空間コンピュータ向け半導体光学融合装置



図表13:BAWフィルタ(バルク表面波フィルタ)向け電子デバイス装置



注:BAWフィルタとは、Bulk Acoustic Wave Filter の略称で、2GHz以上を使う移動体通信システムで必要不可欠であり、SAW(Surface Acoustic Wave:弾性表面波)フィルタは800Mhz~2GHzで使用される

